

富士プリント 部品内蔵基板参入

ーパナソニック開発技術導入

2月生産開始、14.4期売上高1億円ー

小ロット・試作プリント配線板メーカー、富士プリント工業(株) (本社：東京都八王子市下恩方町315-11 TEL042-650-8181 代表者：荒井眞澄氏 資本金：9,980万円 従業員：56人)は、パナソニック(株) (本社：大阪府門真市 代表者：津賀一宏氏)が開発した部品内蔵基板技術「SIMPACT」の技術供与を受け、同市場に参入する。1億円を投じて製造設備を導入するとともに、同社の技術者から指導を受けて事業化に向けた準備を進めており、2月にも生産を開始する予定。2014年4月期に1億円の売り上げを目指す。大手メーカーと競合するスマートフォン向けなどの量産用途は考えておらず、医療機器など小ロット・試作品向けの新規需要を開拓する。

SIMPACTの製造工程は、部品を実装した多層プリント配線板を2枚製造し、2枚の基板の間に部品内蔵層(コンポジットもしくはプリプレグ材)を配置して熱プレスで貼り合わせるというもの。部品内蔵層は、あらかじめビア用の穴を設けて導電性ペーストを充填しておくことで、部品を埋め込むと同時にビア接続を行う。通常の実装基板をそのまま用いるため、既存の製造工程で高い信頼性を持つ部品内蔵基板を製造可能。2枚の4層配線板の間に80個の部品を内蔵した場合、両面実

装の標準モジュールに比べて面積が1/4(25×25mm)に縮小する。部品内蔵とIVH構成により最短配線を実現しているため、ノイズに強いことも特長としている。

部品内蔵基板は、スマートフォンをはじめとしたモバイル機器の一層の小型・高機能化を実現する技術として注目されており、太陽誘電が2011年に本格量産化を打ち出したのに続き、ロームが委託生産により事業化、フジクラが部品内蔵FPCを開発するなど、当該分野に参入する企業が増加しつつある。一方で、市場の立ち上がりには時間を要しており、早くから部品内蔵基板をラインアップに加えている企業であっても継続的に量産している企業は少なく、特定機種向けの受注があった場合にのみ生産している企業が大半とされる。このため、パナソニックはSIMPACTを開発したものの、量産に必要な受注量の確保は困難として独自事業化を見送り、小ロット・試作品メーカーである当社に技術供与することで開発技術の有効活用を図ることとした。

当社はここ、2010年5月に中国合弁会社稼働開始、2011年7月に大阪営業所(大阪市淀川区)開設、2012年5月に(株)双明通信機製作所(2006年子会社化)の本社を東京都青梅市から同瑞穂町に移転し工場を2倍に拡張するなど、多方面から事業強化策を推進している。これら積極策が奏効し、今2013年4月期売上高は16億円に達し、過去最高益を更新する見通し。